



平成24年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成23年9月29日

上場取引所 東

上場会社名 三益半導体工業株式会社
コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 中澤 正幸

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 八高 達郎

TEL 027-372-2011

四半期報告書提出予定日 平成23年10月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年5月期第1四半期の業績(平成23年6月1日～平成23年8月31日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年5月期第1四半期	10,868	△34.5	1,187	50.8	1,115	96.2	639	99.4
23年5月期第1四半期	16,586	40.8	787	22.1	568	207.4	320	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	
	円 銭	円 銭	
24年5月期第1四半期	19.11	—	
23年5月期第1四半期	9.58	—	

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年5月期第1四半期	69,417		51,711		74.5	
23年5月期	74,609		51,485		69.0	

(参考) 自己資本 24年5月期第1四半期 51,711百万円 23年5月期 51,485百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
23年5月期	—	12.00	—	12.00	24.00
24年5月期	—				
24年5月期(予想)		12.00	—	12.00	24.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成24年5月期の業績予想(平成23年6月1日～平成24年5月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	23,000	△29.8	1,600	10.2	1,500	30.8	900	36.8	26.88
通期	50,000	△16.0	2,500	1.4	2,200	8.5	1,200	17.8	35.84

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

24年5月期1Q	35,497,183 株	23年5月期	35,497,183 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

24年5月期1Q	2,014,746 株	23年5月期	2,014,746 株
----------	-------------	--------	-------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年5月期1Q	33,482,437 株	23年5月期1Q	33,483,283 株
----------	--------------	----------	--------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する定性的情報	2
(2) 財政状態に関する定性的情報	2
(3) 業績予想に関する定性的情報	2
2. 四半期財務諸表	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	4
(3) 継続企業の前提に関する注記	5
(4) セグメント情報	5
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	5

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの動きが見られたものの、円高の進行や東日本大震災の影響により景気は依然として厳しい状況となりました。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、東日本大震災後、サプライチェーンの復旧とともに、生産に回復の動きがみられました。

このような経営環境の中で当社は、経営全般にわたる徹底した合理化や効率化の推進、省電力対策の実施など、総力を挙げて粘り強く業績の改善に取り組みました。

当第1四半期累計期間の業績は、産商事業部の売上高が減少したことにより108億6千8百万円と前年同四半期比34.5%の減収となったものの、営業利益は11億8千7百万円(前年同四半期比50.8%増)、経常利益は11億1千5百万円(同96.2%増)、四半期純利益は6億3千9百万円(同99.4%増)と増益になりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、堅調な半導体需要を背景に、主力の300mmウエハーを中心として生産は高水準で推移し、再生ウエハーにつきましても堅調に推移いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みましたが、厳しい経済環境を反映してその他の取扱商品において大幅な減収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化しつつ、産商事業部を通じた自社開発製品の販売活動を積極的に展開いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前事業年度末と比較して51億9千1百万円減少し、694億1千7百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により54億1千7百万円減少し、177億6百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加2億3千8百万円等により、517億1千1百万円となりました。

(3) 業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、円高の進行や世界経済の後退懸念など、わが国経済は予断を許さない厳しい状況が続くものと予想されます。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、半導体デバイス需要の停滞が懸念されるものの、概ね底堅く推移するものと見込まれております。

このような経営環境のもと、当社といたしましては今後も徹底した合理化による低コスト生産体制の構築に取り組むとともに、自社製品等の拡販を積極的に進め、業績の向上に努めてまいります。

なお、未定としておりました平成24年5月期の業績予想及び配当予想につきましては、本日、別途「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて開示いたしております。通期業績は、売上高500億円、営業利益は25億円、経常利益は22億円、当期純利益は12億円を見込んでおります。

また、配当金につきましては、中間、期末ともに前期と同額の1株当たり12円を予定しております。これにより、年間の配当予想は前期と同様1株当たり24円となります。

2. 四半期財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成23年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,051	16,438
受取手形及び売掛金	18,620	18,537
商品及び製品	154	180
仕掛品	374	361
原材料及び貯蔵品	911	878
その他	1,003	638
貸倒引当金	△20	△18
流動資産合計	41,096	37,016
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	15,453	15,099
その他(純額)	14,113	13,502
有形固定資産合計	29,567	28,602
無形固定資産	1,625	1,533
投資その他の資産	2,320	2,266
固定資産合計	33,512	32,401
資産合計	74,609	69,417
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,550	13,075
短期借入金	100	100
未払法人税等	1,087	190
引当金	95	504
その他	3,369	1,913
流動負債合計	21,201	15,784
固定負債		
長期借入金	350	350
退職給付引当金	1,383	1,383
その他	188	187
固定負債合計	1,922	1,921
負債合計	23,123	17,706
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	17,314	17,552
自己株式	△3,409	△3,409
株主資本合計	51,507	51,745
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△21	△33
評価・換算差額等合計	△21	△33
純資産合計	51,485	51,711
負債純資産合計	74,609	69,417

(2) 四半期損益計算書
第1四半期累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年8月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日)
売上高	16,586	10,868
売上原価	15,083	9,010
売上総利益	1,503	1,857
販売費及び一般管理費	715	670
営業利益	787	1,187
営業外収益		
受取利息	1	1
受取配当金	1	1
その他	11	7
営業外収益合計	14	11
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	39	35
設備休止費用	156	42
その他	36	4
営業外費用合計	232	82
経常利益	568	1,115
特別利益		
固定資産売却益	—	0
貸倒引当金戻入額	2	—
特別利益合計	2	0
特別損失		
固定資産除却損	3	22
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	9	—
特別損失合計	12	22
税引前四半期純利益	558	1,094
法人税、住民税及び事業税	123	165
法人税等調整額	114	288
法人税等合計	237	454
四半期純利益	320	639

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

報告セグメントごとの売上高に関する情報

前第1四半期累計期間 (自 平成22年6月1日 至 平成22年8月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	7,586	8,993	5	16,586	—	16,586
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	284	284	△284	—
合計	7,586	8,993	290	16,870	△284	16,586

当第1四半期累計期間 (自 平成23年6月1日 至 平成23年8月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	7,660	3,207	—	10,868	—	10,868
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	—	314	316	△316	—
合計	7,662	3,207	314	11,184	△316	10,868

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。